

股票代码: 300623

股票简称: 捷捷微电



江苏捷捷微电子股份有限公司  
非公开发行股票  
募集资金使用可行性分析报告  
(修订稿)

二〇一九年五月

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”或“公司”）为在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟非公开发行股票不超过 52,500,000 股（含 52,500,000 股），且募集资金总额不超过 91,113.27 万元（含 91,113.27 万元），在扣除发行费用后将用于“电力电子器件生产线建设项目”、“捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目”和补充流动资金。

（本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中相同的含义。）

## 一、本次募集资金使用计划

本次募集资金总额不超过人民币 91,113.27 万元（含 91,113.27 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
电力电子器件生产线建设项目	55,136.00	53,101.05
捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	23,000.00	19,012.22
补充流动资金	19,000.00	19,000.00
合计	97,136.00	91,113.27

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、

优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

## 二、本次募集资金投资项目的概况

### (一) 电力电子器件生产线建设项目

#### 1、项目基本情况

##### (1) 项目概况

本项目投资总额 55,136 万元，项目建设期为 24 个月，拟建在启东经济开发区华石路西侧、钱塘江路北侧。项目主要产品为电力电子器件功率 MOSFET、IGBT、快恢复二极管（FRD）、可控硅（SCR）等。项目总规划用地 100 亩，厂房 8.8 万平方米。项目建设目标：新建电力电子芯片生产线 1 条，年产出 6 英寸芯片 60 万片；封装生产线 5 条（TO-220 系列、TO-3P 系列、SOT-223、89 系列、TO-252 系列、TO-92 系列），年产出自封电力电子器件器件 30 亿只；技术研发及检测线 1 条；实验室 1 个。预计项目建成达产后年产值为 6.21 亿。

##### (2) 项目投资概算

项目投资总额 55,136 万元，主要包括工程建设费、设备购置费、铺底流动资金等，项目具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额
一	工程费用	39,786.00
1	工程建设费	13,020.00
1.1	土地	1,450.00
1.2	厂房	11,570.00
2	设备购置费	26,766.00
二	其他费用	350.00
1	设备安装费	200.00
2	其他设施费	150.00
三	铺底流动资金	15,000.00
合计	项目总投资	55,136.00

##### (3) 项目经济效益评价

项目实施后，达产后的税后利润为 12,262.73 万元。从不确定性分析，本项

目的盈亏平衡点为 33,145.88 万元，投资回收期为 5.84 年（含建设期），内部收益率 21.64%，净现值（ic=10%）为 29,917.90 万元。

#### **（4）项目实施单位**

本项目由江苏捷捷微电子股份有限公司作为投资主体来组织实施，将利用公司位于启东经济开发区华石路西侧、钱塘江路北侧的现有土地进行建设，总规划用地 100 亩，厂房面积为 88,000.00 平方米。

#### **（5）项目涉及的审批事项**

该项目已于 2018 年 3 月 13 日取得启东市行政审批局颁发的《江苏省投资项目备案证》（启行审备[2018]101 号），项目备案总投资 55,136 万元。

该项目已于 2018 年 8 月 1 日取得启东市行政审批局下发的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司电力电子器件生产线建设项目节能评估审查意见》（启行审投（2018）118 号）。

该项目利用公司自有土地，已取得启东市不动产登记局于 2018 年 8 月 10 日颁发的《不动产权证书》（编号：32007651739）。

该项目已于 2018 年 9 月 6 日取得启东市行政审批局下发的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司电力电子器件生产线建设项目环境影响报告书的审查意见》（启行审环（2018）157 号）。

## **2、项目建设的必要性**

### **（1）该项目符合我国产业发展导向，属于国家重点扶持类项目**

2017 年 1 月，国家发改委公布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》（2017 年第 1 号），涉及电子核心产业，进一步明确电力电子功率器件的地位和范围，包括金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）、绝缘栅双极晶体管芯片（IGBT）及模块、快恢复二极管（FRD）、垂直双扩散金属-氧化物场效应晶体管（VDMOS）、可控硅（SCR）、5 英寸以上大功率晶闸管（GTO）、集成门极换流晶闸管（IGCT）、中小功率智能模块。

电力电子器件生产线建设项目的主要产品为电力电子器件功率 MOSFET、

IGBT、快恢复二极管（FRD）、可控硅（SCR）等，属于战略性新兴产业重点产品，符合国家产业发展导向。国家半导体产业政策的技术导向和扶持对公司经营形成了良好的发展环境，鼓励本土企业在拥有自主知识产权的基础上，与国际产品形成良性竞争，降低我国对进口功率半导体分立器件的依赖性。

### **(2) 企业扩大现有产能和实现业务扩张的必经之路**

根据公司现阶段发展情况及市场整体需求情况，客户不断增加的需求与公司产能之间的矛盾将成为公司发展中的主要矛盾，若公司不能及时扩产以满足日益增长的市场需求，将影响公司的成长性。电力电子器件生产线建设项目的实施将有助于公司扩大现有产能及产品覆盖率，实现业务扩张。

### **(3) 该项目有助于企业丰富产品结构，增加经营利润**

本项目将进一步丰富企业的产品结构，深化现有领域的应用深度，拓宽应用广度。项目产品主要包括电力电子器件功率 MOSFET、IGBT、快恢复二极管（FRD）、可控硅（SCR）等。项目的建设升级将带来公司电力电子器件产品的多元化、便利化以及标准化，从而大大增加了产品的销售量。项目实施后，电力电子器件产品线将覆盖更广的领域，形成多领域、广覆盖的多样化优势，进一步增加企业利润来源。

### **(4) 该项目有助于把握电力电子器件产业发展的机遇，提高市场占有率**

随着下游市场需求的快速发展以及国家政策的大力支持，半导体行业的发展正面临历史性机遇，公司也获得了更广阔的市场空间。公司拟通过本次非公开发行股票募集资金实施电力电子器件生产线建设项目，该项目的实施一方面可以增加公司产能满足客户需求，另一方面也将进一步优化公司的产品结构，扩大产业链布局，把握电力电子器件产业发展的机遇，提高市场占有率，增强公司的综合实力。

## **3、项目建设的可行性**

### **(1) 公司具有良好的技术基础，为项目建设提供技术保障**

1) 突出的芯片研发能力和定制化设计能力是公司最主要的核心竞争力之一，也是公司可持续发展的源动力。

国外大型半导体公司以销售标准化产品为主，较少为客户生产定制产品，并且在为客户定制产品时，开发周期相对较长。国内大多数电力电子器件制造商不具备芯片设计制造能力，仅从事半导体分立器件的封装制造。公司立足于我国市场的实际情况，根据终端产品需求多样化和升级换代快的特点，依托于芯片研发设计技术优势，目前已经研发并生产200多种型号和规格的标准产品，并通过对客户需求的评估生产个性化产品。

由于公司下游客户分布行业广泛，客户对产品性能的要求各异，定制产品具有很大的市场需求空间，其附加值也相应较高。公司为客户定制产品，需要结合生产工艺的调整和关键技术的协调匹配，是公司芯片研发能力的重要体现，也是公司差异化发展的重要标志。

**公司60余项功率半导体芯片和器件的核心技术不仅保证公司产品性能优良、工艺领先、质量稳定可靠、性价比高，还可及时根据客户需求设计、生产定制产品，不断推出新产品。**

公司目前形成了以芯片研发和制造为核心、器件封装为配套的完整的生产链，不断提升公司芯片的研发与创新能力，促进新产品、新技术、新材料应用、新工艺的研发成果产业化，突出芯片研发和制造水平，走差异化发展道路。

2) 公司采用IDM的经营模式，具有国内领先的先进制造力优势和完善的管理体系。

电力电子器件制造对工艺设计和工艺过程控制的要求非常高，制造工艺涵盖多道工序，生产过程采用流水制造方式，制造流程较长，公司先进的工艺技术全面应用到芯片设计和制造、成品封装及品质监控及检测的生产过程中，大大提高了产品的性能。

公司的先进制造力综合反映在将多项专利技术和专有技术全面融入生产工艺，形成完善的制造管理体系，不仅提高了产品的各项性能指标，也能够按照客户需求调整生产工艺，拓宽产品种类。

公司完善的管理体系严格监控每一生产步骤，保障产品的可靠性、稳定性和一致性处于行业领先水平。由于半导体分立器件制造行业属于技术密集型行

业，公司先进制造力优势和充足的技术储备有助于公司实现以技术带动发展、以品质占领市场的可持续发展目标。

## **(2) 公司具有优质的客户资源基础，逐步实现国产替代进口**

公司通过技术创新提高产品的附加值，为客户设计生产定制化产品，提高了产品的性价比。公司在维持老客户稳定发展的同时，逐步打开高端客户的市场空间，境内市场份额迅速提高。知名企业对公司产品质量的充分认可是公司稳步拓展市场空间的基础，公司产品正在逐步实现以国产替代进口，降低我国晶闸管、二极管、防护类器件市场对进口的依赖。同时，公司产品也得到了国外知名厂商的认可，公司产品现已出口至韩国、日本、西班牙和台湾等电子元器件技术较为发达的国家或地区，并且对外出口数额逐年提高。公司生产的中高端产品实现替代进口及对外出口上升的趋势，打破了中国电子元器件领域晶闸管、二极管、防护类器件市场受限于国外技术制约的局面。

## **(3) 公司具有丰富的人才储备，为项目建设和管理打下坚实基础**

公司以黄善兵、王成森、黄健、沈卫群、张超、颜呈祥、黎重林、周祥瑞、殷允超、周榕榕、李成军、薛治祥、朱法扬、徐洋、孙家训、侯辉、王志超、钱清友、沈怡东、吴家健、庄翔等为核心的技术团队长期从事电力电子技术的研发工作，不断进行产品技术和生产工艺的创新，在产品生产工艺优化、产品规格开发上具有丰富的经验，为公司自有知识产权的主要研发人员。

在公司丰富的人才储备支持下，公司新建的电力电子器件生产线建设项目在横向丰富现有产品种类、精化生产工艺的同时，依托公司丰富的人才技术经验，还可以进行功率MOSFET等电力电子器件的研发，促进公司未来产品范围全面化发展。

## **(二) 捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目**

### **1、项目基本情况**

#### **(1) 项目概况**

本项目总投资 2.3 亿，项目建设期为 24 个月，项目地点位于南通市苏通科技产业园。项目主要产品主要包括贴片式压敏电阻、贴片式二极管和交、直流光电耦合混合电路，封装形式有 SMX 系列产品、引线插件型 Leaded，表面贴片型 SMD，光电混合集成式厚膜保护模块 Module 及保护电路 Protect IC 等。项目建设目标：新建电子元器件芯片生产线 1 条，配套成品封装线 1 条。年产出 4 英寸圆片 150 万片，器件 20.9 亿只，其中贴片压敏电阻 1.6 亿只，贴片式二极管 17.5 亿只，交直耦 1.8 亿只。项目外购硅单晶片、铜引线框架、环氧树脂框架等生产材料。主要设备有注入机、光刻机、扩散炉、塑料封装压机、分选机、装片机等。预计项目建成达产后年产值为 20,000.00 万元。

## (2) 项目投资概算

项目计划总投资 2.3 亿元，主要包括工程建设费、设备购置费、铺底流动资金等，项目具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额
一	工程费用	19,700.00
1	工程建设费	4,600.00
1.1	土地	1,100.00
1.2	厂房	3,500.00
2	设备购置费	15,100.00
二	其他费用	100.00
1	设备安装费	50.00
2	其他设施费	50.00
三	铺底流动资金	3,200.00
合计	投资总额	23,000.00

## (3) 项目经济效益评价

项目实施后，达产后的税后利润为 4,592.43 万元。从不确定性分析，本项目的盈亏平衡点为 8,756.87 万元，投资回收期为 5.66 年（含建设期），内部收益率 23.24%，净现值（ic=10%）为 13,137.33 万元。

## (4) 项目实施单位

本项目由江苏捷捷微电子股份有限公司全资子公司捷捷半导体有限公司作



为投资主体来组织实施，将利用公司位于江苏南通苏通科技产业园区的现有土地进行建设，总建筑面积约为 40,000.00 平方米。

### **(5) 项目涉及的审批事项**

该项目已于 2017 年 9 月 19 日取得江苏南通苏通科技产业园区行政审批局（发改）颁发的《江苏省投资项目备案证》（苏通行审备[2017]12 号），项目备案总投资 2.3 亿元。

该项目利用捷捷半导体有限公司的自有土地，已取得南通市国土资源局于 2017 年 11 月 22 日颁发的《不动产权证书》（编号：32003502984）。

该项目已于 2018 年 1 月 8 日取得江苏南通苏通科技产业园区行政审批局下发的《关于捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目节能审查意见》（苏通行审发（2018）3 号）。

该项目已于 2018 年 4 月 2 日取得江苏南通苏通科技产业园区行政审批局下发的《关于<捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目环境影响报告书>的批复》（苏通行审发（2018）15 号）。

## **2、项目建设的必要性**

### **(1) 该项目有助于企业丰富产品结构，增加经营利润**

本项目将进一步丰富企业的产品结构，深化现有领域的应用深度，拓宽应用广度。项目产品主要包括贴片式压敏电阻、贴片式二极管和交、直流光电耦合混合电路，封装形式有 SMX 系列产品、引线插件型 Leaded，表面贴装型 SMD，混合集成式厚膜保护模块 Module 及保护电路 Protect IC 等，项目的建设升级将带来公司电子元器件产品的多元化、便利化以及标准化，从而大大增加了产品的销售量。项目实施后，新型片式元器件产品线将覆盖更广的领域，形成多领域、广覆盖的多样化优势，进一步增加企业利润来源。

### **(2) 下游行业的旺盛需求为电子元器件产业发展提供广阔的市场空间**

随着我国照明行业、电源管理、消费电子、工业设备及计算机模/数转换等领域技术的发展和市场需求的增加，对贴片式二极管、光电混合集成电路的需求非常紧迫，而且需求量非常大。

在这一背景下，扩大电力电子器件产品的产能，提高我国电力电子器件产品自给率，是我国电力电子器件产业发展的必然要求。本项目的建设符合电力电子器件产业的发展要求，有利于满足市场需求，提高国内电力电子器件产业的国际竞争力。

### 3、项目建设的可行性

#### (1) 市场前景广阔提供有利条件

未来电子产业的发展将以实用和低价为主，4G、LED、电子书、智能手机、物联网依然是发展的热点。工业电子、汽车电子、IT与消费类电子、手机与网络通信等应用领域更加注重低功耗、低成本设计。电子元器件行业应紧密跟随电子终端产品技术的发展，注重技术的升级换代、小型化和薄膜化。全球电子制造业逐步向中国大陆转移，中国大陆将成为全球片式元器件需求量最大的地区之一。

光电耦合器作为一类通用器件，广泛应用于安全隔离、电噪声隔离电路中，且产品种类较为繁多。光耦器件紧跟目前电子产品的总体设计趋势，在减少工作空间的情况下实现更有效的隔离效果，并提供速度更快的光耦及栅极驱动产品，能够更好的满足下游市场的需求。

#### (2) 政策支持助力产业发展

电子元器件是电子设备及信息系统的重要基础之一，其发展速度、技术水平高低和生产规模，不仅直接影响着电子信息产业的发展，而且对改造传统产业，促进科技进步，提高装备现代化水平都具有重要的现实意义。

国家高度重视电子元器件的发展，截止目前，各部委已出台多项措施支持该产业发展。2016年国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知中提出提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域。实现主动矩阵有机发光二极管(AMOLED)、超高清(4K/8K)量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用。推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化，提升新型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力。

随着国家对电力电子器件产业支持力度明显加大，预计中国电力电子器件产业将步入一轮加速成长的新阶段。

### (三) 补充流动资金

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次非公开发行募集资金补充流动资金 19,000.00 万元。

#### 1、补充流动资金的必要性

充足的流动资金是公司保持稳定增长的关键因素之一，具体来说，主要表现在以下方面：

(1) 在国际环境复杂多变和行业竞争激烈的背景下，公司需保持充裕的现金以应对各种不确定因素

**2018 年以来**，国际环境复杂多变。美国对中国众多新兴高科技产品加征关税，其中，半导体行业属于美国开征关税的重点行业之一。美国对中兴公司的制裁也一度使其停摆，暴露了我国半导体产业受制于人的弱点。国际环境复杂多变、贸易摩擦升级、国内外行业竞争激烈，公司面临的外部环境不利因素增多。

我国的功率半导体器件的起步虽然较晚，但是市场规模增长迅速，目前已经成为了全球最大功率半导体市场之一。但我国的功率半导体生产技术落后，国内产品市场占有率较低，国内市场大多由传统半导体产业的海外厂商所掌控。近年来，国内企业生产技术快速追赶，部分优质公司已跻身行业第二梯队，国内功率半导体器件龙头企业紧跟行业发展趋势积极布局，在中国市场展开激烈竞争。国内外厂商对于国内市场的激烈竞争也使得公司面临更加复杂的竞争局面。

在国际环境复杂多变、国内外行业竞争激烈的局面下，危机与机遇并存，为了应对各种不确定因素，公司有必要保持充足的营运资金。

(2) 资金密集型和技术密集型的行业特点对公司战略布局的实现产生更高的营运资金需求

一般来说，半导体行业的运作模式分为 IDM（整合元件制造商，即覆盖了整个芯片产业链，集芯片设计，制造和封装测试一体的半导体厂商）、Foundry（从事芯片加工制造，拥有晶圆生产技术而不参与设计的半导体公司）、Fabless（主要负责芯片设计而不从事制造的芯片企业）三种。其中，IDM 模式对于公司的资本实力和技术实力要求最高，Foundry 模式其次，Fabless 模式最为常见。

由于公司在功率半导体分立器件的运作模式中采取的是 IDM 模式，亦即公司所生产的功率半导体分立器件从设计、生产制造、封装测试都是公司独立完成的。这就对公司的资金实力和技术实力提供了更高的要求。公司所处的功率半导体行业属于资金密集型和技术密集型行业，其具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、附加值大等特点。

目前，公司一方面需要逐渐稳固现有产品的优势地位，另一方面需要积极布局相应的 MOSFET、IGBT 及第三代半导体器件。这样的战略布局对公司的研发水平、技术积累、研发投入、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求，特别是对公司的资金实力提出了较高的要求，在这种情况下，公司有必要预留充足的营运资金以保障公司发展战略的实现。

### （3）公司业务规模快速扩张产生更高的营运资金需求

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度营业收入分别为 24,146.27 万元、33,160.86 万元、43,080.69 万元和 53,747.09 万元，实现了 30.57% 的复合增长率。销售规模的快速增长将派生出存货、应收账款等经营性流动资产的自然增加，需要公司准备更多的营运资金应对销售规模的快速增加。公司预计自有资金将难以满足业务快速扩张带来的营运资金增加的需求，因此亟需补充流动资金。通过将本次融资的部分募集资金用于补充公司营运资金，将有效减轻公司营运资金压力，避免出现资金瓶颈问题，有利于推动公司业务扩张以及战略发展目标的实现。

### （4）把握整合机会、实现深耕及外延式发展需借力资本

目前，公司所处的功率半导体分立器件行业竞争激烈，但行业的集中度不高，未来随着行业内的不断整合，集中度将有所提高。

为应对行业内不断整合的趋势，行业内的国内龙头企业多采用在原有领域深耕细作、新兴领域快速切入、借力资本把握整合机会、实现深耕及外延式发展的策略，例如扬杰科技近年来不断进行收购兼并，强化了产业链一体化优势。

作为行业内拥有自主知识产权，国内少有的能够设计芯片并进行生产、封测的 IDM 运作模式的公司，公司未来存在着较多的并购整合机会。公司未来将在原有的业务基础上对业务规模进行扩大或者进行产业链的合理延伸，从而进一步增强公司整体实力，提升市场占有率和行业竞争力。为应对行业趋势、把握整合机会、实现深耕及外延式发展，公司需要流动资金支持。

#### (5) 保障现金分红比例产生更高的资金需求

公司历来注重保护中小股东权益和利益，响应证监会和深交所的号召，每年都进行大比例的现金分红。**2014-2018 年度**，公司的现金分红金额分别为 3,500.00 万元、3,500.00 万元、2,808.00 万元、4,730.07 万元以及 **5,391.77 万元**，现金分红比例均在 20% 以上，具体如下表所示：

年度	现金分红金额 (万元)	分红年度归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	现金分红占比
2014 年度	3,500.00	7,722.44	45.32%
2015 年度	3,500.00	8,071.58	43.36%
2016 年度	2,808.00	11,642.64	24.12%
2017 年度	4,730.07	14,414.91	32.81%
<b>2018 年度</b>	<b>5,391.77</b>	<b>16,566.87</b>	<b>32.55%</b>

为了继续贯彻监管机构保护中小股东权益和利益的政策，切实维护中小股东的权益和利益，公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，未来三年，公司将保持至少 20% 的现金分红比例，为保证现金分红资金及分红后公司预留充足的营运资金，公司也需要相应的流动资金对公司业务进行支持。

## 2、补充流动资金金额估算

公司通过创新提升产品及服务的价值，不断开拓优化客户并优化客户结构，2013-2017 年营业收入实现了 21.99% 的复合增长率，按此增长并以 2017 年为基期计算，未来三年的营业收入预计如下：

单位：万元

项目	2017年	2018年E*	2019年E	2020年E
营业收入	43,080.69	53,057.38	64,109.44	78,206.28

\*注：公司《2017年限制性股票激励计划》已设定了2018-2020年营业收入考核指标，本次预计数据不低于《2017年限制性股票激励计划》设定的指标，2018年营业收入预计数为公司《2017年限制性股票激励计划》设定的指标。**2018年公司实际实现营业收入53,747.09万元，超过预测数。**

根据过往经营记录，公司经营性流动资产（应收票据、应收账款、预付账款、存货）和经营性流动负债（应付票据、应付账款、预收账款）与公司的销售收入有较强的相关性。按照2015-2017年平均经营性流动资产销售百分比和平均经营性流动负债销售百分比计算，未来几年的公司经营性流动资产、经营性流动负债和流动资金占用额的计算公式如下：

经营性流动资产=预测营业收入×经营性流动资产销售百分比

经营性流动负债=预测营业收入×经营性流动负债销售百分比

各年末流动资金占用额=各年末经营性流动资产—各年末经营性流动负债

假设本次非公开发行募投项目于2018年起实施，建设期2年，则将于2020年投产并形成新增收入，届时公司将有较强的流动资金需求，流动资金缺口计算如下：

流动资金缺口=2020年底流动资金占用金额—2017年底流动资金占用金额

根据上述相关假设及计算公式，公司需补充流动资金金额计算如下：

单位：万元

项目	最近三年平均比重	2017年/年末	2020年/年末(E)
营业收入	100.00%	43,080.69	78,206.28
经营性流动资产	58.47%	24,755.06	45,730.41
经营性流动负债	13.68%	8,793.94	10,698.41

流动资金占用额	44.79%	15,961.12	35,032.00
<b>流动资金缺口</b>			<b>19,070.88</b>

注：相关测算不构成盈利预测或承诺。

上表可见，至 2020 年公司募投项目建设投产时流动资金缺口约为 19,070.88 万元。为保持公司快速发展过程中良好的资产结构，公司通过本次非公开发行股票募集不超过 1.9 亿元现金用于补充流动资金是必要的。

本次非公开发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展。本次非公开发行的募集资金用于补充流动资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法规关于募集资金运用的相关规定。

### 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

#### (一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次募集资金将有助于公司抓住行业发展的机遇，提高公司电力电子器件和电子元器件的市场占有率，帮助公司实现产业深度融合发展，推动公司进入新的发展阶段。

#### (二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司的财务状况将得到进一步改善，公司总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司净资产收益率下降，每股收益摊薄。但随着募集资金投资项目的建成投产，公司的盈利能力将得到明显提高。本次发行完成后，公司将获得大额募集资金的现金流入，筹资活动现金流入将大幅增加。未来随着募投项目的逐步建成和投产，公司主营业务收入规模将大幅增加，盈利水平得以提高，经营活动产生的现金流入得以增加，从而相应改善公司的现金流状况。

本次非公开发行股票完成后，公司合并报表的总资产及净资产规模均相应增加，进一步提升资金实力，为后续发展提供有力保障；同时促进公司的稳健

经营，增强抵御财务风险的能力。

#### 四、结论

经审慎分析，董事会认为：本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，有利于推进公司主营业务的持续稳定增长、提高公司盈利能力、增强公司核心竞争力、巩固公司市场地位，符合全体股东的根本利益。因此，本次非公开发行股票募集资金运用是必要、可行的。

(以下无正文)



(本页无正文,为《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》之盖章页)

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日